

各 位

会 社 名	テクノクーツ株式会社
代 表 者	取締役社長 岡本克巳 (JASDAQ コード番号 5217)
問い合わせ先	取 締 役 小野文男 管理本部長 (TEL03-5354-8171)
当社の親会社	ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者	取締役社長 外丸勝彦 (東証第2部 コード番号 7705)

### 平成 24 年 3 月 期 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 5 月 11 日に公表いたしました業績予想及び配当予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 平成 24 年 3 月 期 通期業績予想数値の修正(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

##### (1) 修正の内容

(連結)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 23 年 5 月 11 日発表)	4,980	307	261	225	29 円 09 銭
今回修正予想(B)	4,703	434	419	414	53 円 59 銭
増減額(B-A)	△276	126	158	189	
増減率(%)	△5.5	41.2	60.5	84.3	
(ご参考)前期実績 (平成 23 年 3 月 期)	4,764	338	285	254	32 円 84 銭

(個別)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 23 年 5 月 11 日発表)	4,980	234	189	162	21 円 04 銭
今回修正予想(B)	4,668	323	312	320	41 円 46 銭
増減額(B-A)	△311	89	122	158	
増減率(%)	△6.2	38.2	64.6	97.1	
(ご参考)前期実績 (平成 23 年 3 月 期)	4,724	212	176	155	20 円 11 銭

(2) 修正の理由(連結・個別)

当社は半導体製造プロセスの前工程で使われる消耗品の製造・販売を行っております。

当期の業績につきましては、欧州の債務問題、米国や新興国の景気減速懸念から、下半期以降の受注、売上高は、共に大幅に減少するものと予想しておりますが、予想された程の落ち込みは見られませんでした。また、原価低減や経費削減に努めました結果、通期売上高は当初予想を下回りましたが、営業利益、経常利益が予想を上回る見込みとなりました。当期純利益につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、今後の課税所得が見込める状況となったことから、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討しました結果、繰延税金資産を35百万円程度計上する予定にしており、大幅に予想を上回る見込みであります。

(注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 配当予想の修正

(1) 修正の内容

基準日	1株当たり配当金(円)				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
前回予想 (平成23年5月11日発表)	—	0.00	—	5円00銭	5円00銭
今回修正予想	—	0.00	—	7円00銭	7円00銭
当期実績	—	0.00	—		
前期実績(平成23年3月期)実績	—	0.00	—	5円00銭	5円00銭

(2) 修正の理由

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題として認識しております。また、急速な技術革新に対応した設備投資、競争力の維持・強化を図るための財務体質の強化や長期的な視野に立った配当水準の向上に取り組む方針であります。

当期は、上記業績予想の修正のとおり、通期業績見通しが当初の予想を上回る見込みとなったことから、株主の皆様への利益還元のため、期末配当を当初予想に対して2円増配の1株当たり7円に修正することといたしました。

なお、本件は平成24年6月15日開催予定の定時株主総会において付議する予定であります。

以 上